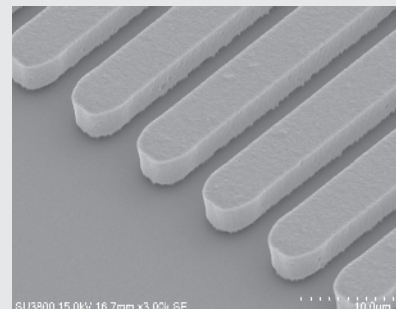
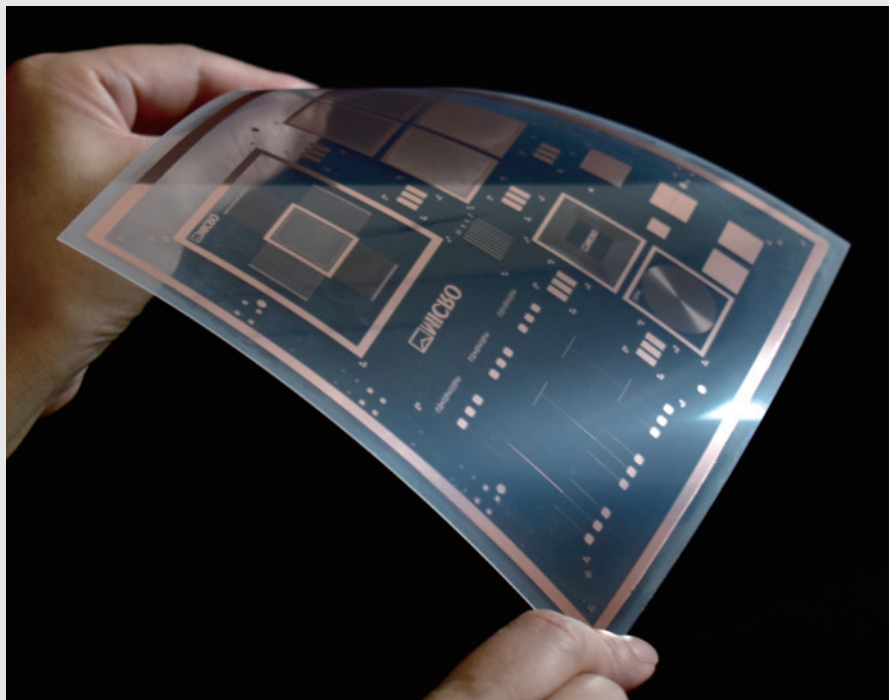
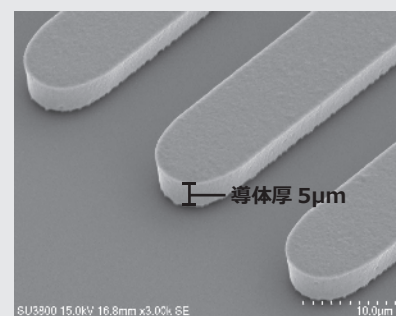


ガラススリミング配線基板

スリミング加工技術によりガラスを任意の厚みにすることに加え、セミアディティブ銅めっき法を用い、超薄型ガラス基板上に密着強度の高い電極を形成いたします。



L/S 5/5µm



L/S 10/10µm

X3000

仕 様

- 板 厚 : 0.05~0.33mm
- ガラスサイズ : 150×150mm
- 材 質 : ソーダガラス ホウケイ酸ガラス
- 電極形成 : (シード層 SP Ti/Cu)+セミアディティブ銅めっき
- 導 体 厚 : 0.2~7µm
- 最小線幅 : L/S 5/5µm
- 密 着 : 1kN 以上